

供南京,浙江,上海,合肥,青岛,大连,天津,锡膏

产品名称	供南京,浙江,上海,合肥,青岛,大连,天津,锡膏
公司名称	苏州工业园区泰硕电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TSP266 粘度:200 (Pa · S) 颗粒度:25 ~ 45 (um)
公司地址	苏州工业园区唯亭镇张泾工业小区D幢
联系电话	0512-86887698 13656202619

产品详情

型号	TSP266	粘度	200 (Pa · S)
颗粒度	25 ~ 45 (um)	品牌	TESA
规格	Sn99Ag0.3Cu0.7	合金组份	锡银铜
活性	高	类型	RA
清洗角度	免清洗	熔点	217

泰硕的无铅锡膏tsp266合金组成:sn99ag0.3/cu0.7 由无铅锡低氧化度的球形焊料末组成,具有优越的环保性,体系中采用高性能触变剂,具有优越的溶解性和持续性,适用于细间距器件[qfp等]的贴装。

1、优点 outstanding features a : 使用无铅合金 b : 在连续印刷时可获得稳定之印刷性,影响粘度甚小。
c : 在叉型模式可以获得绝佳之可印刷性。 d : 在各类型之组件上均有良好的可焊性,适当的润湿性。
e : 芯片侧极少发生锡球 f : 适用于热风回流和 g: 在高温时可以获得优越的焊锡性

2、合金组成 a : sn96.5/ag3.0/cu0.5 217 b: sn99.3/cu0.7 227 c: sn95.5/ag3.9cu0.6 d: sn/ag/bi e: sn42/bi58 139

3、品质保证期 quality guarantee period 品质保证期为生产后六个月 (在密封保存于10 以下)